

2011年(平成23年)9月26日(月曜日)

# セミコン台灣 2011

## 注目の日系材料企業

3

Sとは、接着剤が塗布され

ている。フィルム表面に膜乳化法で製造した微小はんだ MEMSなどの次世代実にも対応可能である。

(猪狩前特派員 おわり)

奥野支社長は「台湾の大手パッケージメーカーはLED実装にも取り組んでいる。当社はLEDもワイヤボンドからボールボンドに移行すると予測し、フリップチップ実装に適合可能なAgナノペーストの開発にも取り組んでいる」と語る。

千住金属工業は、先端領域の半導体実装に独自の接合技術と高機能な材料を提供することで台湾の半導体産業に貢献する。

千住金属工業  
千住金属工業は、微小パッケージ用フリップチップ向けに、機能性に優れたマイクロボールや、転写用はんだシートPPSを展示した。C4はんだバンプやT-SV積層などの接合技術として、はんだ材料を提供する。

千住金属工業は、従来のボルト接続からボール接続に移行しつつあり高密度化、低価格化が進んでいる。足する、はんだボールを製造している。

大型ウエハーサイズへの造している。

「マイクロボール方式では、150召前ピッチが限界と思われる。さらなる狭難どし「転写用はんだシートPPS法」が必要となる。千住金属工業は独自のSPG膜乳化法で、それらの要求を十分満足する、はんだボールを製造している。

野将晴支社長）。

同社は、3Dや3次元

# 千住金属工業

## フリップチップ用 転写用はんだシートなど展示

奥野支社長㊨とスタッフ一同



日刊  
電波新聞

発行所 電波新聞社

東京本社  
東京都品川区東五反田1-11

—15 〒141-8715  
(電)03(3445)6111(大代表)

大阪本社

大阪市中央区北浜3-2-1  
(京阪淀屋橋ビル6階) 〒541-  
0041

-0041  
⑧06(6203)3361(大代表)

西部本社  
福岡市博多区博多駅前2-13

—23(扇寿ビル) 〒812-0011  
⑨092(431)7411(大代表)

©電波新聞社 2006

---